

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

江苏艾森半导体材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-008

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒电话会议 ☐其他
参与单位名称	中信证券、宝盈基金、新华基金、翻沐科技、申万菱信基金、中银基金、混沌投资、尚诚资产、国金基金、高信百诺、鹏山资产、红土创新、创金合信、格林基金、金百镭投资、红杉资本、五地投资、恒邦兆丰资管、狐尾松资产、恒立私募基金、长江资管、闻天投资、禹田资本、东方资管、华泰证券、招商证券、银河证券、方正证券、天风证券、平安证券、浙商证券
时间	2025 年 10 月 27 日
地点	电话会
上市公司 接待人员姓名	常务副总经理、董事会秘书：陈小华 财务总监：吕敏 合规总监：李珮媛 证券事务代表：徐雯
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司管理层介绍 2025 年三季度经营情况 经营业绩：2025 年前三季度，公司实现营业收入 4.39 亿元，同比增长 40.71%；实现归母净利润 3,447.61 万元，同比增长 44.67%；扣非归母净利润 3,170.08 万元，同比增长 86.80%，主要受益于下游终端需求的持续

增长，公司营业收入同比稳健增长。2025 年前三季度研发投入 4,827.70 万元，同比增长 40.26%，占营业收入的比例为 10.99%，研发实力不断增强。

二、问答交流环节

问题一：公司光刻胶产品壁垒及核心竞争力？

答：首先是技术壁垒，目前国内光刻胶在差异化竞争过程中，公司具备高端光刻胶研发能力，且具备从原材料结构设计、树脂合成纯化到光刻胶配方开发到工艺验证等完整链条的研发和供应，光刻胶关键原材料自主可控。其次是客户与市场壁垒，公司产品通过头部客户的严苛认证，并稳定批量供应，客户粘性强，相比进口产品，供货周期更短；并且在先进封装用光刻胶领域，公司为国产唯一供应商，填补国内空白。最后是研发与专利壁垒，公司累计申请光刻胶相关发明专利 49 项（已授权 21 项），覆盖负性光刻胶、负性 PSPI 光刻胶、化学放大型正性光刻胶等高端产品线。

问题二：公司产品进展情况。

答：公司在晶圆领域、先进封装领域、半导体显示以及 IC 载板领域产品均有所突破。在晶圆领域，5-14nm 先进制程的超高纯硫酸钴基液已获得主流晶圆客户的首个国产化量产订单；公司 28nm 大马士革铜互连工艺镀铜添加剂产品已经通过主流晶圆客户的认证，进入量产阶段。在先进封装领域，公司负性光刻胶已成功拓展应用到玻璃基封装，获得头部客户量产订单。公司 TSV 电镀添加剂及适用于 Bumping 与 RDL 工艺的电镀添加剂、TGV 工艺高速镀铜添加剂在客户端测试验证中。半导体显示领域，公司 OLED 阵列用高感度 PFAS Free 正性光刻胶，已顺利通过了头部面板客户的验证。IC 载板领域，公司 Tenting 快速填孔镀铜产品已成功导入头部 HDI 和 SLP 供应链，实现批量供货。公司 MSAP 用电镀配套试剂已在 IC 载板客户端实现批量供货。

问题三：公司研发投入展望？

答：公司 2025 前三季度研发投入 4,827.70 万元，同比增长 40.26%，主要系公司进一步加大先进封装及晶圆制造先进制程领域，尤其光刻

	胶、超纯化学品等高端及“卡脖子”产品的研发投入。公司在研发投入方面的展望主要聚焦于半导体材料领域的技术突破与国产替代，投入集中于光刻胶、先进封装及晶圆制造高端材料，如 KrF 光刻胶、PSPI 光刻胶、TSV 工艺镀铜添加剂等。 问题四：IC 载板领域的产品布局？ 答：IC 载板作为芯片与系统之间关键连接，其电镀工艺要求兼具高均匀性与精细图形能力，公司高均匀性电镀液专为载板电镀设计，可同时满足微孔填充与图形电镀的双重需求，提升产品一致性和良率。公司 MSAP 用电镀配套试剂已在 IC 载板客户端实现批量供货，MSAP 用 Pattern 填孔镀铜产品目前正处于 IC 载板客户端测试阶段。 问题五：公司在存储领域的布局情况。 答：公司在存储芯片领域的布局聚焦于电镀液与光刻胶双工艺协同，目前已与国内头部存储客户做技术交流，公司相关产品成熟，产品已适配国产存储芯片制造全流程，预计验证测试周期相对较短。 问题六：公司并购方面规划。 答：公司在并购方面的规划主要围绕半导体材料产业链的垂直整合与横向拓展，结合公司“一主两翼”（半导体电镀光刻+半导体显示+光伏新能源）战略及全球化布局需求，并购策略以技术协同和市场份额为核心，通过资本运作加速国产替代。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	无
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 10 月 27 日